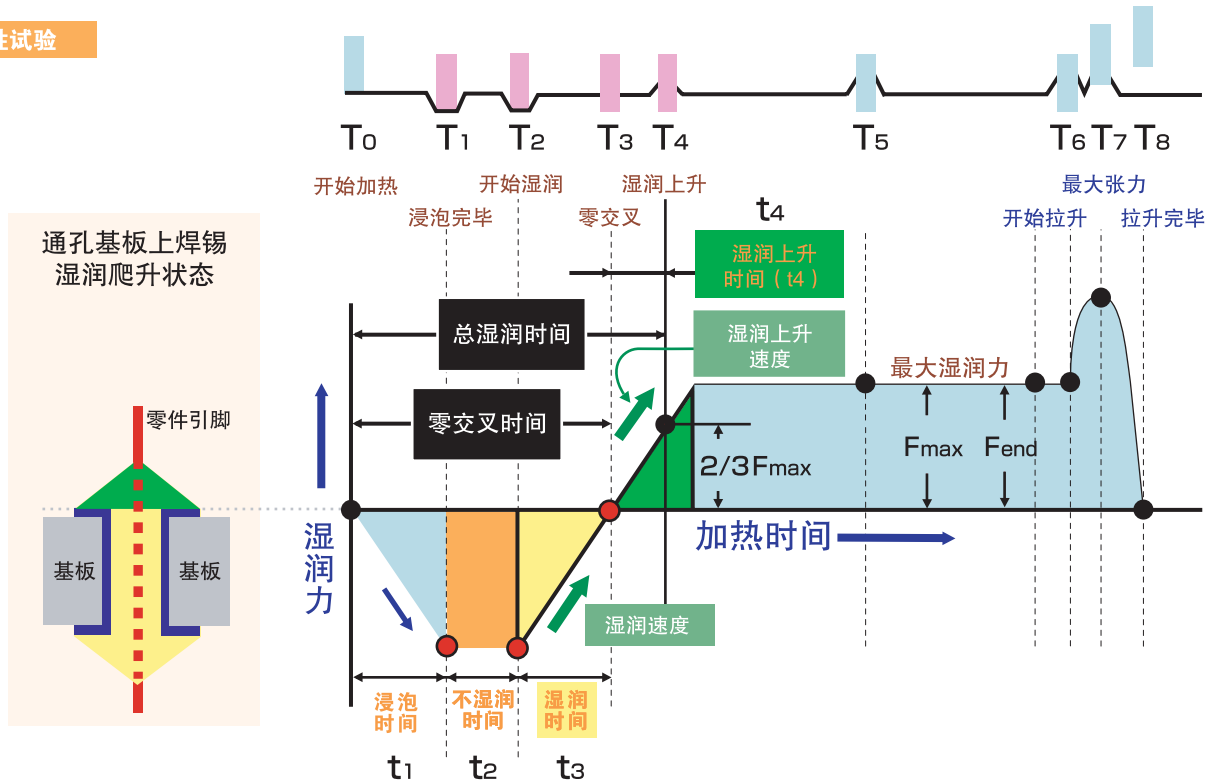


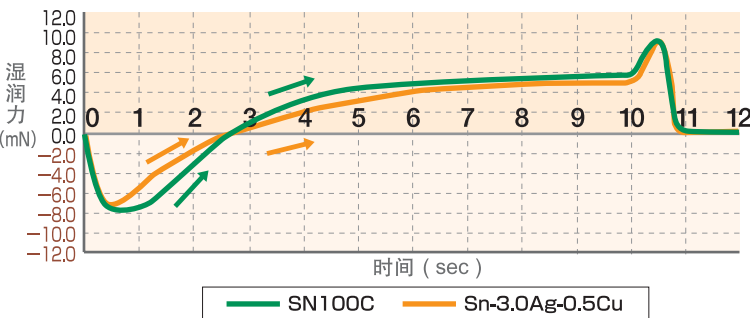
# 湿润性

作为焊接性的评价方法之一，有湿润性实验（JIS Z 3198-4: 2003 湿润平衡法）。此实验一般评价零交叉时间和总湿润时间、最大湿润力等。总湿润时间分为浸泡时间、不湿润时间、湿润时间、湿润上升时间，在通孔板上通孔部在湿润时间开始焊锡吸收，焊锡面以上的零件脚的焊接在湿润上升时间里进行焊接。因此，通孔板上的焊接其湿润时间和焊锡上升时间非常重要。SN100C的湿润至一开始就需要时间，一旦开始湿润其湿润速度和湿润上升速度比Sn-3.0Ag-0.5Cu焊锡要快，其总湿润时间就变快。SN100C是将线路板铜箔和零件脚适当的加热，把不湿润时间能够缩短进而得到良好的湿润性的无铅焊锡。（SN100C的波峰焊接推荐温度为250度-260度）。

## 湿润性试验

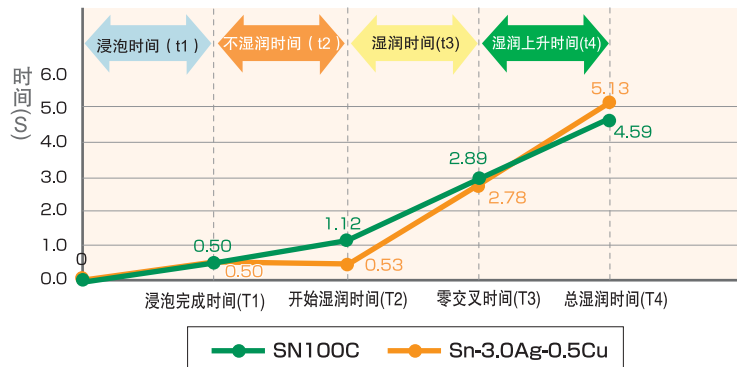


■ SN100C vs Sn-3.0Ag-0.5Cu 湿润性实验  
倾斜差=湿润速度的差异，湿润上升速度差异



[实验条件]  
实验片：铜板  
(厚度0.3mm,宽10mm,长30mm)  
助焊剂：NS-831  
熔融温度：255度  
浸泡深度：2mm  
浸泡速度：4mm/s  
浸泡时间：10s  
吊起速度：2mm/s

■ 湿润时间，湿润上升时间的比较



时间	SN100C (s)	Sn-3.0Ag-0.5Cu(s)	SN100C和Sn/3.0Ag/0.5Cu的比较 (%)
浸泡时间(t1)	0.50	0.50	100
不湿润时间(t2)	0.62	0.03	2067
湿润时间(t3)	1.77	2.25	79
湿润上升时间(t4)	1.70	2.35	72
零交叉时间(T3)	2.89	2.78	104
总湿润时间(T4)	4.59	5.13	89